

# ESP32-P4

## 硬件设计指南



Release master  
乐鑫信息科技  
2025 年 12 月 26 日

# Table of contents

<b>Table of contents</b>	<b>i</b>
<b>1 本文档的最新版本</b>	<b>3</b>
1.1 关于本文档 . . . . .	3
1.1.1 简介 . . . . .	3
1.1.2 请使用最新版本文档 . . . . .	3
1.2 产品概述 . . . . .	3
1.3 原理图设计 . . . . .	4
1.3.1 概述 . . . . .	4
1.3.2 电源 . . . . .	4
1.3.3 上电时序与复位 . . . . .	8
1.3.4 Flash 及 PSRAM . . . . .	9
1.3.5 时钟源 . . . . .	10
1.3.6 UART . . . . .	11
1.3.7 SPI . . . . .	11
1.3.8 Strapping 管脚 . . . . .	11
1.3.9 GPIO . . . . .	12
1.3.10 ADC . . . . .	14
1.3.11 SDIO . . . . .	14
1.3.12 USB . . . . .	15
1.3.13 触摸传感器 . . . . .	16
1.3.14 以太网 MAC . . . . .	16
1.3.15 MIPI . . . . .	16
1.4 PCB 版图布局 . . . . .	16
1.4.1 基于芯片的版图设计通用要点 . . . . .	17
1.4.2 晶振 . . . . .	17
1.4.3 USB . . . . .	17
1.4.4 SDIO . . . . .	18
1.4.5 触摸传感器 . . . . .	18
1.4.6 MIPI . . . . .	21
1.5 开发硬件介绍 . . . . .	22
1.5.1 ESP32-P4 系列开发板 . . . . .	22
1.5.2 下载指导 . . . . .	22
1.6 相关文档和资源 . . . . .	22
1.6.1 ESP32-P4 系列模组 . . . . .	22
1.6.2 ESP32-P4 系列开发板 . . . . .	23
1.6.3 其他文档和资源 . . . . .	23
1.7 词汇列表 . . . . .	23
1.8 修订历史 . . . . .	23
1.9 免责声明和版权公告 . . . . .	24



本文档是 [ESP32-P4](#) 系列芯片的硬件设计指南。

		
<a href="#">原理图设计</a>	<a href="#">PCB 版图布局</a>	<a href="#">开发硬件介绍</a>



# Chapter 1

## 本文档的最新版本

请查看以下链接，以确保使用的是本文档的最新版本：[https://docs.espressif.com/projects/esp-hardware-design-guidelines/zh\\_CN/latest/esp32p4/index.html](https://docs.espressif.com/projects/esp-hardware-design-guidelines/zh_CN/latest/esp32p4/index.html)

### 1.1 关于本文档

#### 1.1.1 简介

《ESP 硬件设计指南》提供基于 ESP32-P4 芯片的硬件设计的指导规范。这些规范将帮助您提升电路和 PCB 版图设计的准确性，以实现产品的最佳性能。本文的目标读者是硬件设计师和应用开发人员。

#### 1.1.2 请使用最新版本文档

点击链接确保您使用的是最新版本的文档：[https://docs.espressif.com/projects/esp-hardware-design-guidelines/zh\\_CN/latest/esp32p4/index.html](https://docs.espressif.com/projects/esp-hardware-design-guidelines/zh_CN/latest/esp32p4/index.html)

### 1.2 产品概述

ESP32-P4 系列芯片支持以下功能：

- 搭载 RISC-V 32 位双核与单核处理器的高性能 MCU
- 强大的图像与语音处理能力
- 芯片封装内叠封 16 MB 或 32 MB PSRAM
- 55 个 GPIO，丰富的外设

ESP32-P4 采用低功耗 40 纳米工艺，具有超高的稳定性、通用性和可靠性，以及超低的功耗，满足不同的功耗需求，适用于各种应用场景。ESP32-P4 的典型应用包括：

- 智能家居
- 工业自动化
- 医疗保健
- 消费电子产品
- 智慧农业
- POS 机

- 服务机器人
- 音频设备
- 通用低功耗 IoT 传感器集线器
- 通用低功耗 IoT 数据记录器
- 摄像头视频流传输
- USB 设备
- 语音识别
- 图像识别
- 触摸和接近感应

---

**备注：**除非特别说明，文中使用的“ESP32-P4”指的是 ESP32-P4 系列芯片，而非单一型号。

---

## 1.3 原理图设计

### 1.3.1 概述

ESP32-P4 系列芯片的核心电路只需要 40 个左右的电阻电容电感和 1 个无源晶振，以及 1 个 SPI flash, 1 个 DCDC。为了能够更好地保证 ESP32-P4 系列芯片的工作性能，本章将详细介绍 ESP32-P4 系列芯片的原理图设计。

下图所示为 ESP32-P4 的核心电路参考设计，可以将它作为原理图设计的基础。

ESP32-P4 系列芯片的核心电路图的设计有以下重要组成部分：

- 电源
- 上电时序与复位
- *Flash 及 PSRAM*
- 时钟源
- *UART*
- *Strapping* 管脚
- *GPIO*
- *ADC*
- *SDIO*
- *USB*
- 触摸传感器
- 以太网 *MAC*
- *MIPI*

下文将分别对这些部分进行描述。

### 1.3.2 电源

电源电路设计的通用要点有：

- 使用单电源供电时，建议供给 ESP32-P4 的电源电压为 3.3 V。
- ESP32-P4 的基本供电电流至少为 430 mA (含 flash 和 PSRAM)，各个外设的供电电流请参考 [HP/LP IO 电源](#)，[MIPI PHY 电源](#) 和 [USB PHY 电源](#)。请根据具体应用选择合适的电源芯片。
- 建议在各个总电源入口处添加 10  $\mu$ F 电容。
- 电源管理如图 [ESP32-P4 系列芯片电源管理](#) 所示。

有关电源管脚的更多信息，请查看 [ESP32-P4 系列芯片技术规格书](#) > 章节 电源。

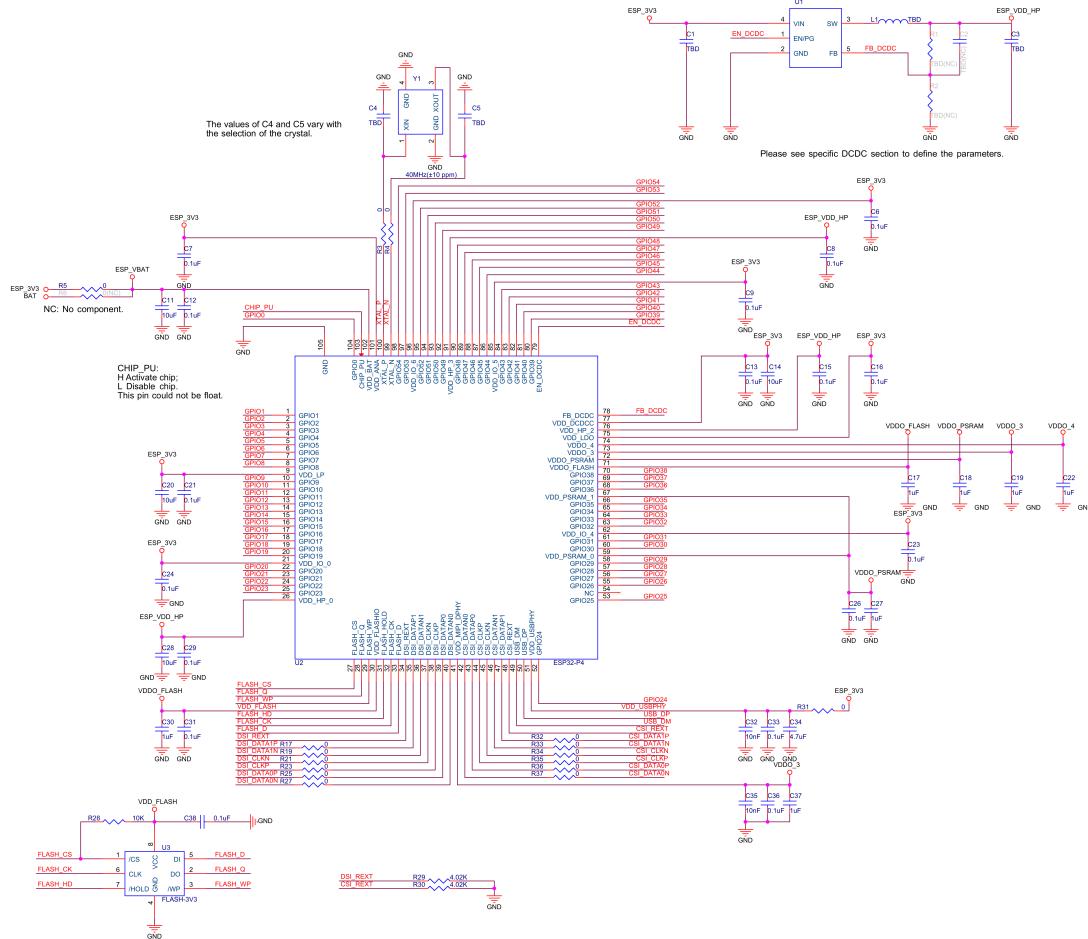


图 1: ESP32-P4 系列芯片参考设计原理图

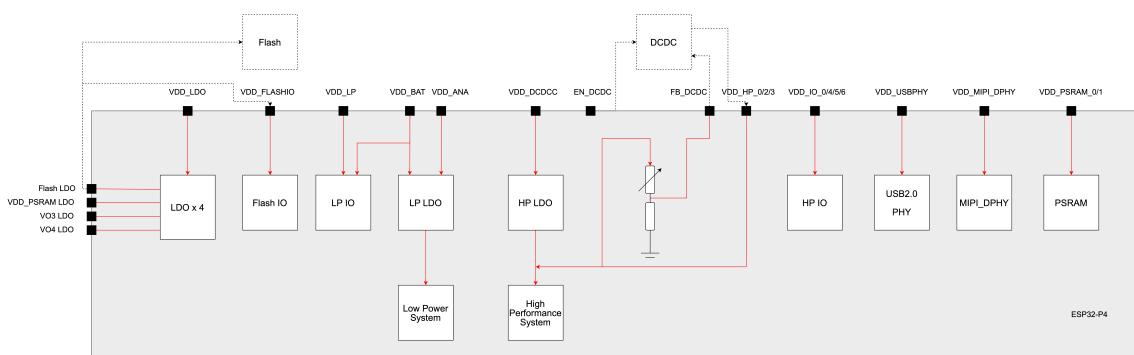


图 2: ESP32-P4 系列芯片电源管理

## HP/LP IO 电源

管脚序号	管脚名称	管脚方向	电压范围 (V)	最大拉电流 (mA)	IO 管脚	管脚处电容 ( $\mu$ F)
9	VDD_LP	输入	3.0 ~ 3.6	100	LP IO	0.1
21	VDD_IO_0	输入	1.65 ~ 1.95/3.0 ~ 3.6	100	HP IO	0.1
62	VDD_IO_4	输入	1.65 ~ 1.95/3.0 ~ 3.6	100	HP IO	0.1
85	VDD_IO_5 <sup>1</sup>	输入	1.65 ~ 1.95/3.0 ~ 3.6	100	HP IO	0.1
96	VDD_IO_6	输入	1.65 ~ 1.95/3.0 ~ 3.6	100	HP IO	0.1

## MIPI PHY 电源

ESP32-P4 的管脚 VDD\_MIPI\_DPHY 为 MIPI PHY 电源管脚，工作电压范围为 2.25 V ~ 2.75 V，最大电流功耗为 50 mA。推荐使用内部电压稳压器供电，建议在电路中靠近 VDD\_MIPI\_DPHY 管脚处添加 10 nF + 0.1  $\mu$ F + 1  $\mu$ F。

如果不需要 MIPI 功能，管脚 VDD\_MIPI\_DPHY 可以悬空。

**注意：**MIPI 信号电平由 MIPI 协议规定，具体可以查阅 MIPI 协议相关文档，和 MIPI DPHY 电平是两个概念。摄像头/显示屏规格书中提到的 1.8 V/3.3 V 指的是除 MIPI 信号 (Data Lane & CLK) 之外的信号电平，如 MCLK 和 I2C 等。MIPI 信号电平由 ESP32-P4 内部 MIPI DPHY 自行处理，无需额外配置。

## USB PHY 电源

ESP32-P4 的管脚 VDD\_USBPHY 为 USB PHY 电源管脚，工作电压范围为 2.97 V ~ 3.63 V，最大电流功耗为 20 mA。建议在电路中靠近 VDD\_USBPHY 电源管脚处添加 10 nF + 0.1  $\mu$ F + 4.7  $\mu$ F。

如果不需要高速 USB 2.0 OTG 功能，管脚 VDD\_USBPHY 可以悬空。如果使用了该电源，并且对功耗有要求，因为该电源无法完全关闭，在低功耗模式下有额外的耗电，建议添加一个 MOSFET 电路完全关断和外部电源的连接。初始可以预留一个串联电阻在 VDD\_USBPHY 上。

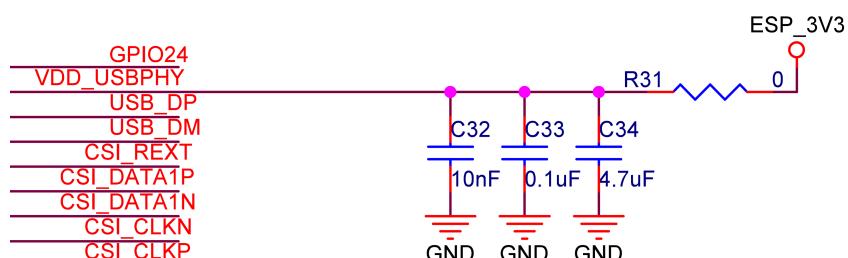


图 3: VDD\_USBPHY 电路参考设计

<sup>1</sup> VDD\_IO\_5 如果作为 SD 3.0 接口 IO 电源，电路请参考 [SDIO](#)。

## Flash 和 PSRAM IO 电源

ESP32-P4 的管脚 VDD\_FLASHIO 为 FLASH IO 电源管脚，工作电压范围为 1.65 V ~ 1.95 V/3.0 V ~ 3.6 V。该电源由内部电压稳压器输出 VDDO\_FLASH 提供，建议在电路中靠近 VDD\_FLASHIO 电源管脚处添加 0.1  $\mu$ F + 1  $\mu$ F。

管脚 VDD\_PSRAM\_0 和 VDD\_PSRAM\_1 为 PSRAM IO 电源管脚，工作电压范围为 1.65 V ~ 1.95 V。该电源由内部电压稳压器输出 VDDO\_PSRAM 提供，建议在电路中靠近 VDD\_PSRAM\_0 和 VDD\_PSRAM\_1 电源管脚处添加 0.1  $\mu$ F + 1  $\mu$ F。

## 模拟电源

ESP32-P4 的管脚 VDD\_ANA 为模拟电源管脚，工作电压范围为 3.0 V ~ 3.6 V。建议在电路中靠近 VDD\_ANA 电源管脚处添加 0.1  $\mu$ F。管脚 VDD\_BAT 为模拟电源管脚，工作电压范围为 3.0 V ~ 3.6 V，建议在电路中靠近 VDD\_ANA 电源管脚处添加 0.1  $\mu$ F + 10  $\mu$ F。

VDD\_BAT 电源管脚不可悬空，可外接电池，请参考 [ESP32-P4 备用电池供电方案](#)。

## 数字电源

ESP32-P4 的管脚 VDD\_HP\_0、管脚 VDD\_HP\_2 和管脚 VDD\_HP\_3 为数字电源管脚，工作电压范围为 0.99 V ~ 1.3 V。该电源由外部 DCDC 输出 ESP\_VDD\_HP 提供，建议在总电源处添加 10  $\mu$ F，在各个电源管脚处添加 0.1  $\mu$ F。

## 内部电压稳压器和外部 DCDC

ESP32-P4 的管脚 VDD\_LDO 为内部电压稳压器提供电源，工作电压范围为 3.0 V ~ 3.6 V。管脚 VDD\_DCDCC 为 DCDC 控制部分提供电源，工作电压范围为 3.0 V ~ 3.6 V。因为管脚电流较大，请在 VDD\_LDO 和 VDD\_DCDCC 的电源走线上放置一个 10  $\mu$ F 电容，再在各个管脚处添加 0.1  $\mu$ F。

内部电压稳压器输出 VDDO\_FLASH 给外部 flash 供电，默认输出 3.3 V 电压，可以通过烧写 EFUSE\_OPXA\_TIEH\_SEL\_0 使 VDDO\_FLASH 输出 1.8 V。

**备注：**在 eFuse 配置之前，VDDO\_FLASH 默认输出 3.3 V 电压，此时接到 1.8 V flash 会有风险。因此，使用 1.8 V flash 时，建议在 VDDO\_FLASH 和 VDD\_FLASHIO 之间加一个跳帽，直到 VDDO\_FLASH 电压确认为 1.8 V 之后再供电给 flash。

表 1: VDDO\_FLASH 电压控制

VDDO_FLASH 电源	EFUSE_OPXA_TIEH_SEL_0	电压
flash 稳压器	0	3.3 V
	2	1.8 V

内部电压稳压器输出 VDDO\_PSRAM 给内部 PSRAM 供电，输出典型值为 1.9 V 电压，需要软件配置，默认输出 0。

内部电压稳压器输出 VDDO\_3/4 给外设供电，最大输出电流 50 mA，输出电压范围为 0.5 V ~ 2.7 V/3.3 V，需要软件配置，默认输出 0。

软件配置请参考 [低压差线性稳压器 \(LDO\)](#)。

建议在电路中靠近 VDDO\_FLASH、VDDO\_PSRAM、VDDO\_3/4 电源管脚处添加 1  $\mu$ F。

VDD\_HP\_0/2/3 系列电源由外部 DCDC 供电，其中：

- 外部 DCDC 的输入和 VDD\_DCDCC 电源一致。

- 管脚 EN\_DCDC 为外部 DCDC 的使能管脚。在下载模式和没有固件的情况下，EN\_DCDC 电压为 0。正常启动固件后，EN\_DCDC 由内部控制。在下载模式下，EN\_DCDC 电压为 0。在睡眠模式下，可以通过管脚 EN\_DCDC 关闭该系列的电源从而降低功耗。
- 管脚 FB\_DCDC 为外部 DCDC 的反馈管脚。
- 管脚 EN\_DCDC 与 FB\_DCDC 默认由 ESP32-P4 内部电路全权控制，请务必将其分别连接至外部 DCDC 的 EN 与 FB 管脚。布局时必须预留反馈电阻与反馈电容的焊盘位置（无需上件），同时确保 DCDC 紧靠 ESP32-P4 放置。

请使用验证过的 DCDC 型号：ETA3485/SY8088/RY3420/TLV62569。输入、输出和电感参数请按照具体的规格书设计，下图为 TLV62569 的电路设计。

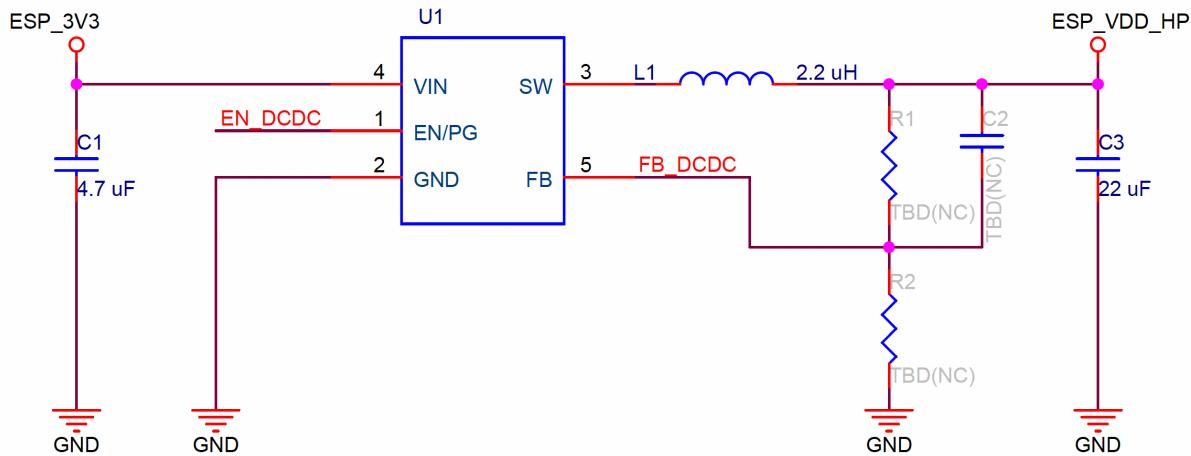


图 4: TLV62569 电路参考设计

### 1.3.3 上电时序与复位

ESP32-P4 的 CHIP\_PU 管脚为高电平时使能芯片，为低电平时复位芯片。

当 ESP32-P4 使用 3.3 V 系统电源供电时，电源轨需要一些时间才能稳定，之后才能拉高 CHIP\_PU，激活芯片。因此，CHIP\_PU 管脚上电要晚于系统电源 3.3 V 上电。

复位芯片时，复位电压  $V_{IL\_nRST}$  范围应为  $(-0.3 \sim 0.25 \times VDD\_BAT)$  V。为防止外界干扰引起重启，CHIP\_PU 管脚引线需尽量短一些。

图 [ESP32-P4 系列芯片上电和复位时序图](#) 为 ESP32-P4 系列芯片的上电、复位时序图。

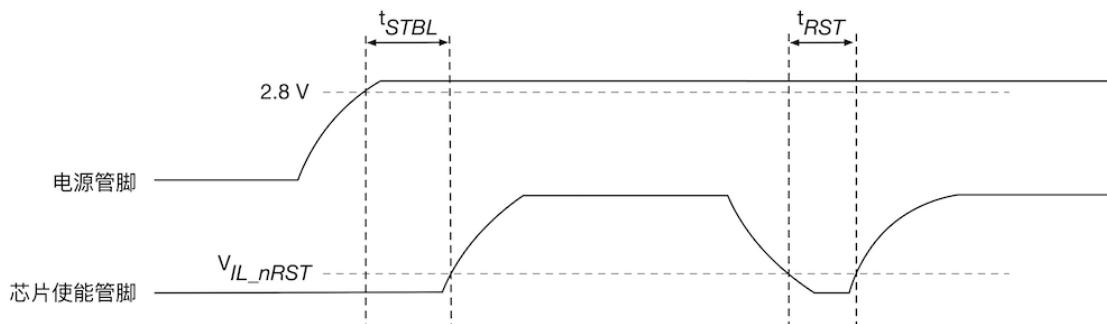


图 5: ESP32-P4 系列芯片上电和复位时序图

上电和复位时序参数说明见表 [上电和复位时序参数说明](#)。

表 2: 上电和复位时序参数说明

参数	说明	最小值 (μs)
t <sub>STBL</sub>	CHIP_PU 管脚上电晚于电源管脚上电的延时时间	50
t <sub>RST</sub>	CHIP_PU 电平低于 V <sub>IL_nRST</sub> 从而复位芯片的时间	1000

**注意:**

- CHIP\_PU 管脚不可浮空。
  - 为确保芯片上电和复位时序正常, 一般采用的方式是在 CHIP\_PU 管脚处增加 RC 延迟电路。RC 通常建议为  $R = 10 \text{ k}\Omega$ ,  $C = 0.1 \mu\text{F}$ , 但具体数值仍需根据实际的电源特性配合芯片的上电、复位时序进行调整。
  - 如果应用中存在以下场景:
    - 电源缓慢上升或下降, 例如电池充电;
    - 需要频繁上下电的操作;
    - 供电电源不稳定, 例如光伏发电等。
- 此时, 仅仅通过 RC 电路不一定能满足时序要求, 有概率会导致芯片无法进入正常的工作模式。
- 此时, 需要增加一些额外的电路设计, 比如:
- 增加复位芯片或者看门狗芯片, 通常阈值为 3.0 V 左右;
  - 通过按键或主控实现复位等。

### 1.3.4 Flash 及 PSRAM

ESP32-P4 系列芯片需配合封装外 flash 一起使用, 用于存储应用的固件和数据。ESP32-P4 支持以 SPI、Dual SPI、Quad SPI 等接口形式连接 flash, 最大可支持 64 MB flash。

ESP32-P4 系列芯片内部封装了 OPI/HPI 1.8 V PSRAM, 请注意 PSRAM 引脚并没有引出芯片。

下面的表格列出了 ESP32-P4 与封装外 flash 的管脚对应关系。请注意这些芯片管脚最多连接一个 flash。

表 3: 芯片与封装外 Quad SPI Flash 的管脚对应关系

ESP32-P4	封装外 Flash (Quad SPI)
FLASH_CK	CLK
FLASH_CS	CS#
FLASH_D	DI
FLASH_Q	DO
FLASH_WP	WP#
FLASH_HOLD	HOLD#

请注意默认使用 VDDO\_FLASH 输出电源作为 flash 的电源, 默认使用 VDDO\_PSRAM 输出电源作为 PSRAM 的电源。

当 VDDO\_FLASH 为 3.3 V 输出模式的时候, VDD\_LDO 需要考虑到  $R_{VFB}$  的影响。比如在接 3.3 V flash 的情况下需满足以下条件:

$$VDD_LDO > VDD_{flash\_min} + I_{flash\_max} \times R_{VFB}$$

其中,  $VDD_{flash\_min}$  为 flash 的最低工作电压,  $I_{flash\_max}$  为 flash 的最大工作电流,  $R_{VFB}$  是 3.3 V 模式导通电阻。

**注意:**

- 建议 SPI flash 通信线上预留  $0 \Omega$  串联电阻, 以便在需要时进行灵活调整, 实现降低驱动电流、减小对射频的干扰、调节时序、提升抗干扰能力等功能。
- 请在 FLASH\_CS 管脚处添加上拉电阻。

- 建议在 flash 电源处添加 0.1  $\mu\text{F}$  电容。

### 1.3.5 时钟源

ESP32-P4 外部可以有两个时钟源：

- 外置主晶振时钟源（必选）
- RTC 时钟源（可选）

#### 外置主晶振时钟源（必选）

目前 ESP32-P4 系列芯片固件仅支持 40 MHz 晶振。

ESP32-P4 的无源晶振部分电路如图 [ESP32-P4 系列芯片无源晶振电路图](#)。注意，选用的无源晶振自身精度需在  $\pm 10 \text{ ppm}$ 。

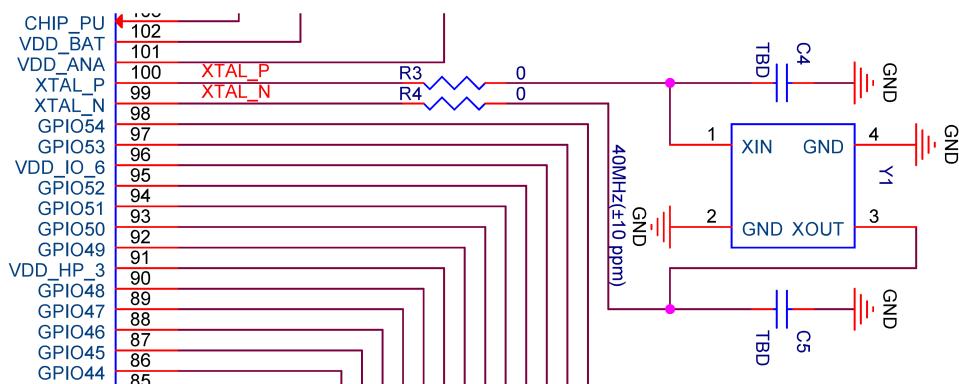


图 6: ESP32-P4 系列芯片无源晶振电路图

外部匹配电容 C4 和 C5 的初始值可参考以下公式来决定：

$$C_L = \frac{C_4 \times C_5}{C_4 + C_5} + C_{stray}$$

其中  $C_L$ （负载电容）的值可查看所选择晶振的规格书， $C_{stray}$  的值为 PCB 的寄生电容。C4 和 C5 的最终值需要通过对系统测试后进行调节确定。

#### RTC 时钟源（可选）

ESP32-P4 支持外置 32.768 kHz 的无源晶振作为 RTC 时钟。使用外部 RTC 时钟源是为了使时间更准确，从而降低平均功耗，但对于功能没有任何影响。

外置 32.768 kHz 无源晶振的电路如图 [ESP32-P4 系列芯片外置 32.768 kHz 无源晶振电路图](#) 所示。

请注意 32.768 kHz 晶振选择要求：

- 等效内阻 (ESR)  $\leq 70 \text{ k}\Omega$ 。
- 两端负载电容值根据晶振的规格要求进行配置。

并联电阻 R 用于偏置晶振电路，电阻值要求  $5 \text{ M}\Omega < R \leq 10 \text{ M}\Omega$ 。该电阻一般无需上件。

如果不需要该 RTC 时钟源，则 32.768 kHz 晶振的管脚也可配置为 GPIO 使用。

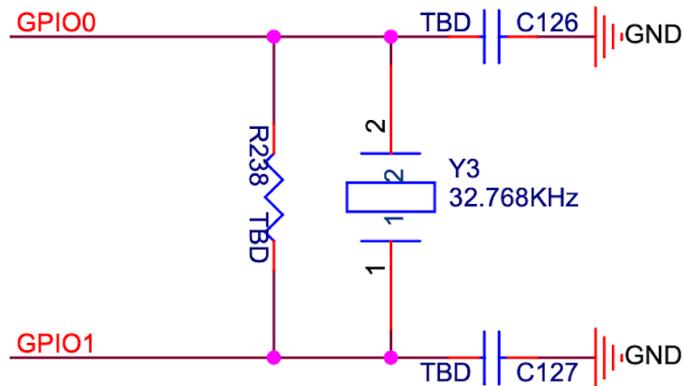


图 7: ESP32-P4 系列芯片外置 32.768 kHz 无源晶振电路图

### 1.3.6 UART

ESP32-P4 有 5 个 UART 接口，即 UART0 ~ UART4，5 个 UART 均支持 CTS 和 RTS 信号的硬件流控以及软件流控 (XON 和 XOFF)。ESP32-P4 还有 1 个 LP UART，LP UART 支持 CTS 和 RTS 信号的硬件流控以及软件流控 (XON 和 XOFF)。

UART0\_TXD 和 UART0\_RXD 默认为 GPIO37 和 GPIO38，其他 UART0 信号可以通过软件配置到任意空闲 GPIO 管脚上。LP UART TXD 和 LP UART RXD 默认为 LP GPIO14 和 LP GPIO15，其他 LP UART 信号可以通过软件配置到任意空闲 LP GPIO 管脚上。

UART0 通常作为下载和 log 打印的串口，关于如何使用 UART0 进行下载，请参考章节[下载指导](#)。

推荐使用 UART1 ~ UART4 作为通信的串口。

### 1.3.7 SPI

在使用 SPI 功能时，为了提高 EMC 性能，请在 SPI\_CLK 线上添加串联电阻 (或磁珠) 以及对地电容。如果空间允许，建议在其他 SPI 线上也添加串联电阻和对地电容。另外，请确保 RC/LC 器件靠近芯片或模组的管脚放置。

### 1.3.8 Strapping 管脚

芯片每次上电或复位时，都需要一些初始配置参数，如加载芯片的启动模式等。这些参数通过 strapping 管脚控制。复位放开后，strapping 管脚和普通 IO 管脚功能相同。

GPIO34、GPIO35、GPIO36、GPIO37、GPIO38 为 strapping 管脚。

所有的 strapping 管脚信息，可参考[ESP32-P4 系列芯片技术规格书](#) > 章节 启动配置项。下面主要介绍和启动模式有关的 strapping 管脚信息。

芯片复位释放后，GPIO35、GPIO36、GPIO37 和 GPIO38 共同决定启动模式，详见表[芯片启动模式控制](#)。

表 4: 芯片启动模式控制

启动模式	GPIO35	GPIO36	GPIO37	GPIO38
SPI Boot 模式 (默认)	1	任意值	任意值	任意值
Joint Download 模式 <sup>2</sup>	0	1	任意值	任意值

<sup>2</sup> Joint Download 模式下支持以下下载模式：

- USB Download Boot:
  - USB-Serial-JTAG Download Boot
  - USB 2.0 OTG Download Boot
- UART Download Boot
- SPI Slave Download Boot

Strapping 管脚的时序参数包括 建立时间和 保持时间。更多信息，详见图Strapping 管脚的时序参数图 和 表Strapping 管脚的时序参数说明。

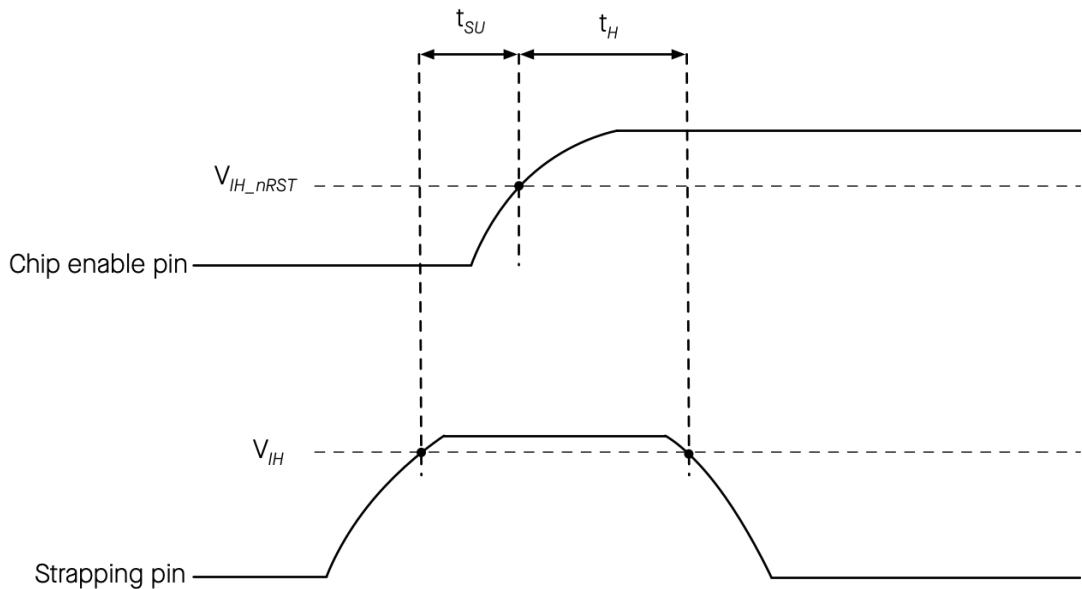


图 8: Strapping 管脚的时序参数图

表 5: Strapping 管脚的时序参数说明

参数	说明	最小值 (ms)
$t_{SU}$	建立时间，即拉高 CHIP_PU 激活芯片前，电源轨达到稳定所需的时间	0
$t_H$	保持时间，即 CHIP_PU 已拉高、strapping 管脚变为普通 IO 管脚开始工作前，可读取 strapping 管脚值的时间	3

**注意：**

- 建议在 GPIO35 管脚处预留上拉电阻。
- 建议不要在 GPIO35 管脚处添加较大的电容，可能会导致进入下载模式。

### 1.3.9 GPIO

ESP32-P4 系列芯片通过 IO MUX 表格或者 GPIO 交换矩阵来配置 GPIO。IO MUX 是默认的外设管脚配置（详见 [ESP32-P4 系列芯片技术规格书 > 附录 ESP32-P4 管脚总览](#)），GPIO 交换矩阵用于将可以配置的外设信号传输至 GPIO 管脚。更多关于 IO MUX 和 GPIO 交换矩阵的信息，请参考 [ESP32-P4 技术参考手册 > 章节 IO MUX 和 GPIO 交换矩阵](#)。

部分外设的 GPIO 管脚是固定的，部分是可以任意配置的，具体信息请参考 [ESP32-P4 系列芯片技术规格书 > 章节 外设](#)。

使用 GPIO 时，请注意：

- Strapping 管脚的上电状态。
- 请注意 GPIO 复位后的默认配置，详见表[IO 默认管脚配置](#)。建议对处于高阻态的管脚配置上拉或下拉，或在软件初始化时开启管脚自带的上下拉，以避免不必要的耗电。
- Deep-sleep 模式下只能控制电源域为 VDD\_LP 的 GPIO。

- 仅用电池供电时只能控制电源域为 VDD\_BAT 的 GPIO。

表 6: IO 默认管脚配置

管脚序号	管脚名称	供电管脚	复位时	复位后
1	GPIO1	VDD_LP/VDD_BAT	—	—
2	GPIO2	VDD_LP/VDD_BAT	—	IE, WPU
3	GPIO3	VDD_LP/VDD_BAT	—	IE
4	GPIO4	VDD_LP	—	IE
5	GPIO5	VDD_LP	—	—
6	GPIO6	VDD_LP	—	—
7	GPIO7	VDD_LP	—	—
8	GPIO8	VDD_LP	—	—
10	GPIO9	VDD_LP	—	—
11	GPIO10	VDD_LP	—	—
12	GPIO11	VDD_LP	—	—
13	GPIO12	VDD_LP	—	—
14	GPIO13	VDD_LP	—	—
15	GPIO14	VDD_LP	—	—
16	GPIO15	VDD_LP	—	—
17	GPIO16	VDD_IO_0	—	—
18	GPIO17	VDD_IO_0	—	—
19	GPIO18	VDD_IO_0	—	—
20	GPIO19	VDD_IO_0	—	—
22	GPIO20	VDD_IO_0	—	—
23	GPIO21	VDD_IO_0	—	—
24	GPIO22	VDD_IO_0	—	—
25	GPIO23	VDD_IO_0	—	—
52	GPIO24	VDD_IO_4	—	—
53	GPIO25	VDD_IO_4	—	IE, USB_PU
55	GPIO26	VDD_IO_4	—	—
56	GPIO27	VDD_IO_4	—	—
57	GPIO28	VDD_IO_4	—	—
58	GPIO29	VDD_IO_4	—	—
60	GPIO30	VDD_IO_4	—	—
61	GPIO31	VDD_IO_4	—	—
63	GPIO32	VDD_IO_4	IE	—
64	GPIO33	VDD_IO_4	IE	—
65	GPIO34	VDD_IO_4	IE	—
66	GPIO35	VDD_IO_4	IE, WPU	—
68	GPIO36	VDD_IO_4	IE	—
69	GPIO37	VDD_IO_4	IE	—
70	GPIO38	VDD_IO_4	IE	—
80	GPIO39	VDD_IO_5	—	—
81	GPIO40	VDD_IO_5	—	—
82	GPIO41	VDD_IO_5	—	—
83	GPIO42	VDD_IO_5	—	—
84	GPIO43	VDD_IO_5	—	—
86	GPIO44	VDD_IO_5	—	—
87	GPIO45	VDD_IO_5	—	—
88	GPIO46	VDD_IO_5	—	—
89	GPIO47	VDD_IO_5	—	—
90	GPIO48	VDD_IO_5	—	—
92	GPIO49	VDD_IO_6	—	—
93	GPIO50	VDD_IO_6	—	—
94	GPIO51	VDD_IO_6	—	—

下页继续

表 6 - 续上页

管脚序号	管脚名称	供电管脚	复位时	复位后
95	GPIO52	VDD_IO_6	—	—
97	GPIO53	VDD_IO_6	—	—
98	GPIO54	VDD_IO_6	—	—
104	GPIO0	VDD_LP/VDD_BAT	—	—

### 1.3.10 ADC

使用 ADC 功能时, 请靠近管脚添加 0.1  $\mu$ F 的对地滤波电容, 精度会更准确一些。

ADC 通道信号	管脚名称
ADC1_CHANNEL0	GPIO16
ADC1_CHANNEL1	GPIO17
ADC1_CHANNEL2	GPIO18
ADC1_CHANNEL3	GPIO19
ADC1_CHANNEL4	GPIO20
ADC1_CHANNEL5	GPIO21
ADC1_CHANNEL6	GPIO22
ADC1_CHANNEL7	GPIO23
ADC2_CHANNEL0	GPIO49
ADC2_CHANNEL1	GPIO50
ADC2_CHANNEL2	GPIO51
ADC2_CHANNEL3	GPIO52
ADC2_CHANNEL4	GPIO53
ADC2_CHANNEL5	GPIO54

### 1.3.11 SDIO

ESP32-P4 系列芯片只有一个 SD/MMC 主机控制器, 不能用做从机, SDIO 2.0 和 SDIO 3.0 接口需要分时复用。

SDIO 2.0 接口信号可以通过 GPIO 交换矩阵配置到任意空闲的 GPIO 上, 在 SDIO 3.0 接口中, 部分信号的管脚是固定的, 请按照下表所示方式连接。

请在 SDIO GPIO 管脚处添加上拉电阻, 建议每根线上预留一个串联的电阻, 并在 SDIO CLK 线上预留对地的电容用于调节。

考虑到 SDIO 3.0 协议中 SDIO GPIO 工作电压自动切换的要求, 建议把 SDIO GPIO 的电源域 VDD\_IO\_5 和外部上拉电源连接至 VDDO\_4。SD 卡供电电源请连接至系统 3.3 V 电源。

为了降低 SD 卡的功耗和复位 SD 卡, 可以在 SD 卡电源处预留 MOS 管电路, 通过 GPIO 来控制。

表 7: SDIO 3.0 接口配置

SDIO 信号	管脚名称
SD1_CDATAL0_PAD	GPIO39
SD1_CDATAL1_PAD	GPIO40
SD1_CDATAL2_PAD	GPIO41
SD1_CDATAL3_PAD	GPIO42
SD1_CCLK_PAD	GPIO43
SD1_CCMD_PAD	GPIO44
SD1_CDATAL4_PAD	GPIO45
SD1_CDATAL5_PAD	GPIO46
SD1_CDATAL6_PAD	GPIO47
SD1_CDATAL7_PAD	GPIO48

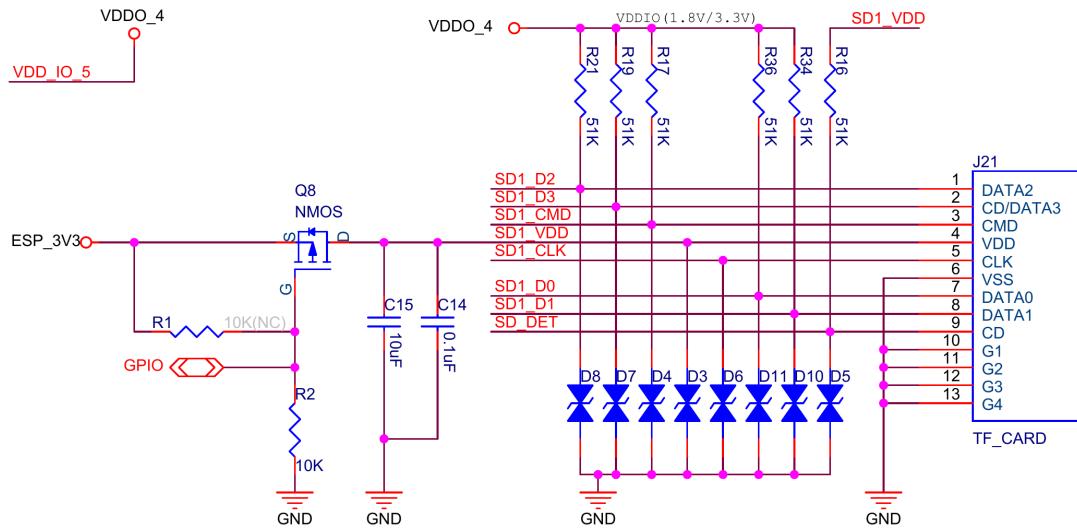


图 9: ESP32-P4 SD 3.0 卡电源电路图

### 1.3.12 USB

ESP32-P4 系列芯片集成一个 USB 串口/JTAG 控制器，默认使用 GPIO24 和 GPIO25 作为 USB 的 D- 和 D+。

ESP32-P4 系列芯片带有一个集成了收发器的全速 USB On-The-Go (OTG) 外设，符合 USB 2.0 规范，默认使用 GPIO26 和 GPIO27 作为 USB 的 D- 和 D+。

使用 USB 串口/JTAG 控制器和全速 USB On-The-Go (OTG) 外设时，请注意：

- USB 的 D- 和 D+ 管脚功能可以互换。
- 使用单个功能时，可以选择 GPIO24/GPIO25 和 GPIO26/GPIO27 其中任意一组。
- 同时使用两个功能时，GPIO24/GPIO25 和 GPIO26/GPIO27 各自作为一个功能的两个管脚使用。

ESP32-P4 系列芯片带有一个集成了收发器的高速 USB On-The-Go (OTG) 外设，符合 USB 2.0 规范，DM 和 DP 分别作为 USB 的 D- 和 D+。

全速 USB 的 D- 和 D+ 线上建议预留串联电阻（初始值可为  $22/33 \Omega$ ）和对地电容（初始可不上件），并注意靠近芯片端放置。

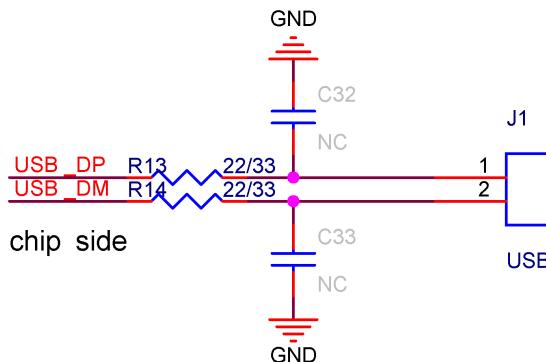


图 10: ESP32-P4 系列芯片 USB RC 电路图

建议在 USB 连接器端预留 ESD 保护二极管。当使用高速 USB OTG 外设时，请注意 ESD 保护二极管的寄生电容不能超过  $1 \text{ pF}$ ，否则会导致信号质量较差，传输不稳定。

ESP32-P4 系列芯片也支持通过 USB 进行下载, 请参考[下载指导](#)。

### 1.3.13 触摸传感器

使用 TOUCH 功能时, 建议靠近 ESP32-P4 侧预留串联电阻, 用于减小线上的耦合噪声和干扰, 也可加强 ESD 保护。该阻值建议  $470\ \Omega$  到  $2\ k\Omega$ , 推荐  $510\ \Omega$ 。具体值还需根据产品实际测试效果而定。

ESP32-P4 系列芯片的触摸传感器同时还支持防潮功能和遇水保护功能。防潮设计可缓和小水珠带来的影响, ESP32-P4 触摸传感器引入 Shield Pad 这一特殊 PAD。用户可以任选一个触摸管脚作为 Shield Pad, Shield Pad 会和当前正在测量的触摸管脚进行并联, 有效缓和水滴带来的影响。

### 1.3.14 以太网 MAC

EMAC RMII 接口 GPIO 配置请见下表。

表 8: EMAC 接口配置

EMAC 信号	管脚名称
RMII_RXDV	GPIO28, GPIO45, GPIO51
RMII_RXD0	GPIO29, GPIO46, GPIO52
RMII_RXD1	GPIO30, GPIO47, GPIO53
RMII_RXER	GPIO31, GPIO48, GPIO54
RMII_CLK	GPIO32, GPIO44, GPIO50
RMII_TXEN	GPIO33, GPIO40, GPIO49
RMII_TXD0	GPIO34, GPIO41
RMII_TXD1	GPIO35, GPIO42
RMII_TXER	GPIO36, GPIO43

建议在 RMII CLK 线上预留串联电阻用于调节。

请注意 RMII 接口中的时钟信号仅为输入, 如果要使用时钟输出的方案, 请使用 REF\_50M\_CLK\_PAD 信号 (GPIO23/GPIO39)。

### 1.3.15 MIPI

ESP32-P4 带有一个 MIPI DSI 接口, 用于连接 MIPI 接口的显示屏; 它还带有一个 MIPI CSI 接口, 用于连接 MIPI 接口的摄像头。请在 CSI\_REXT 和 DSI\_REXT 管脚处各添加  $4.02\ k\Omega$  下拉电阻。

建议在 MIPI 通信线上预留串联电阻 (初始可使用  $0\ \Omega$ ), 主要作用为降低驱动电流, 调节时序, 提升抗干扰能力等。

如果设计中有射频模块, 请在 CSI 接口对接的设备端也添加串联电阻以降低对射频模块的干扰。

**注意:**

- 如果不使用 MIPI 接口, 电源和外置电阻管脚可以悬空。
- 对于 MIPI 接口的设备, 其控制信号请使用 GPIO。

## 1.4 PCB 版图布局

本章节将以 ESP32-P4 开发板的 PCB 布局为例, 介绍 ESP32-P4 系列芯片的 PCB 布局设计要点。

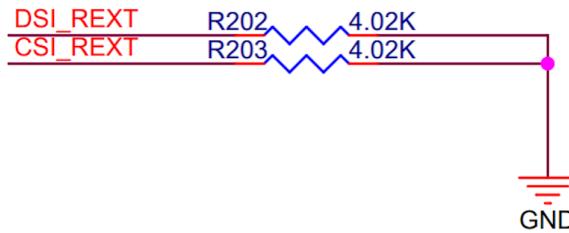


图 11: ESP32-P4 MIPI 信号电路图

### 1.4.1 基于芯片的版图设计通用要点

考虑到高速信号线的通信质量和对射频模块的干扰问题, 请至少采用四层板设计, 即:

- 第一层 (顶层), 主要用于走信号线和摆件。
- 第二层 (地层), 不走信号线, 保证一个完整的地平面。
- 第三层 (电源线层), 将电源走在该层; 条件允许的话, 将高速信号线走在该层并且保证参考平面完整。
- 第四层 (底层), 可走信号线。

### 电源走线通用要点

- 电源走线请尽量走在内层 (非地层), 通过过孔连接至芯片管脚处。电源走线周围注意包地良好。
- 3.3 V 总电源的走线的线宽建议至少 25 mil。
- VDD\_LP、VDD\_IO\_0、VDD\_IO\_4、VDD\_IO\_5 与 VDD\_IO\_6 各个管脚的电源走线建议至少 10 mil, 这系列电源入口处请放置一个 10  $\mu$ F 电容, 然后在每个电源管脚上放置一个 0.1  $\mu$ F 电容。
- VDD\_HP\_0、VDD\_HP\_2 与 VDD\_HP\_3 的总电源走线的线宽建议至少 20 mil, 这系列电源入口处请放置一个 10  $\mu$ F 电容, 然后在每个电源管脚上放置一个 0.1  $\mu$ F 电容。
- VDD\_LDO 和 VDD\_DCDCC 因为电源电流较大, 请在两个电源管脚附近放置一个 10  $\mu$ F 电容, 走线建议至少 20 mil。
- 每个系列的电源走线建议通过星型走线的方式分给各个电源管脚。
- VDD\_HP 电源的 DCDC 请靠近芯片放置, 保证输入、输出和反馈回路尽可能小。因为 VDD\_HP 电源默认由 ESP32-P4 内部完全控制, 因此外部 DCDC 请靠近芯片放置, 保证输入、输出和反馈回路尽可能小。

### 1.4.2 晶振

下图为 ESP32-P4 系列芯片晶振参考设计图。

晶振设计应遵循以下规范:

- 需要保证晶振和芯片有一个完整的地平面。
- 晶振需离芯片时钟管脚稍远一些放置, 防止晶振干扰到芯片。间距应至少为 4.5 mm。同时晶振走线须用地包起来周围密集地孔屏蔽隔离。
- 晶振的时钟走线不可打孔走线。
- 晶振上的串联元器件请靠近芯片放置。
- 晶振外接的对地调节电容请靠近晶振左右两侧摆放, 不可直接连接在串联元器件上。电容尽量置于时钟走线连接末端, 保证电容的地焊盘靠近晶振的地焊盘放置。
- 晶振下方都不能走高频数字信号, 最好是晶振下方不走任何信号线。晶振时钟走线两侧的电源线上的过孔应尽可能地远离时钟走线放置, 并使时钟走线两侧尽可能包地。
- 晶振为敏感器件, 晶振周围不能放置磁感应器件, 比如大电感等, 保证晶振周围有干净的大面积地平面。

### 1.4.3 USB

USB 版图设计应遵循以下规范:

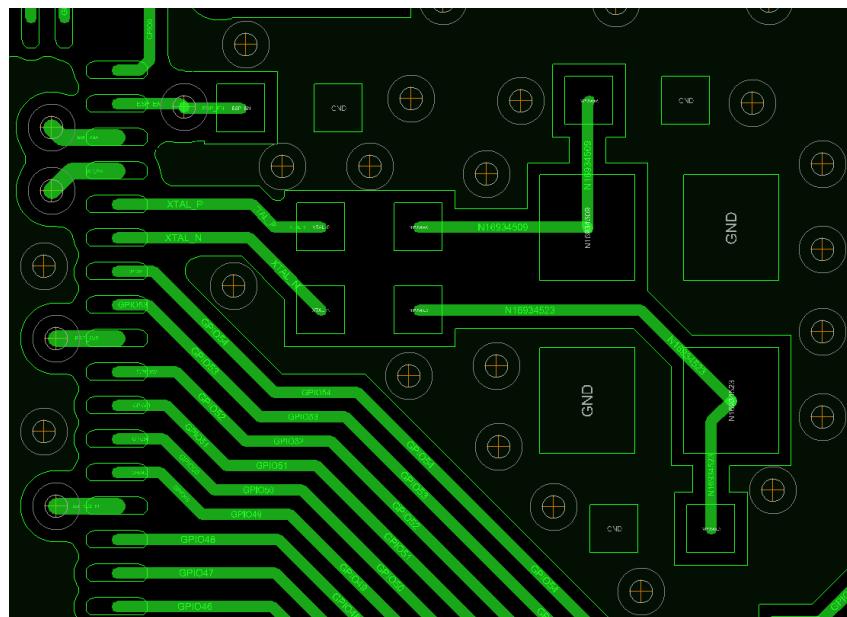


图 12: ESP32-P4 系列芯片晶振设计

- USB 线上预留的电阻和电容请靠近 ESP32-P4 放置。
- USB 走线请按照差分走线，差分线阻抗控制标准是  $90\ \Omega$ ，误差不能大于  $\pm 10\%$ ，保持平行等长。
- USB 差分走线尽可能减少打孔换层，从而可以更好的做到阻抗的控制，避免信号的反射。如果必须打孔，请在每次打孔换层的地方加一对地孔回流。
- USB 走线下方一定要有参考层（推荐用地层），且一定要保证参考层的连续性。
- USB 走线两侧请注意包地处理。

#### 1.4.4 SDIO

SDIO 版图设计应遵循以下规范：

- SDIO 走线因为速率较高，需要尽量控制其寄生电容。
- SDIO\_CMD、SDIO\_DATA0 ~ SDIO\_DATA3 走线长度以 SDIO\_CLK 走线长度为基准  $\pm 50\ \text{mil}$ ，需要时绕蛇形线。
- SDIO 走线请保证  $50\ \Omega$  单端阻抗控制，误差不能大于  $\pm 10\%$ 。
- 从芯片 SDIO 管脚到对端 SDIO 接口的总长度越短越好，最好在  $2000\ \text{mil}$  以内。
- SDIO 走线要保证不跨平面。SDIO 走线下方一定要有参考层（推荐用地层），且一定要保证参考层的连续性。
- SDIO\_CLK 走线两侧请注意包地处理。
- 对于层数较多的 PCB 设计，建议 SDIO 走线在芯片引出后立即通过过孔引入内层，以降低高速信号线的干扰。同时，请在打孔换层的地方加一对地孔回流。

#### 1.4.5 触摸传感器

ESP32-P4 提供多达 14 个电容式传感 IO，能够探测由手指或其他物品直接接触或接近而产生的电容差异。这种设计具有低噪声和高灵敏度的特点，可以用于支持使用相对较小的触摸板。矩阵按键的设计可以得到更多的触摸点。接近感应的设计可以检测到人体的接近。

图 [ESP32-P4 典型的触摸传感器应用](#) 为典型触摸传感应用。

为防止电容耦合和其他电干扰影响触摸传感系统的灵敏度，需要考虑以下因素：

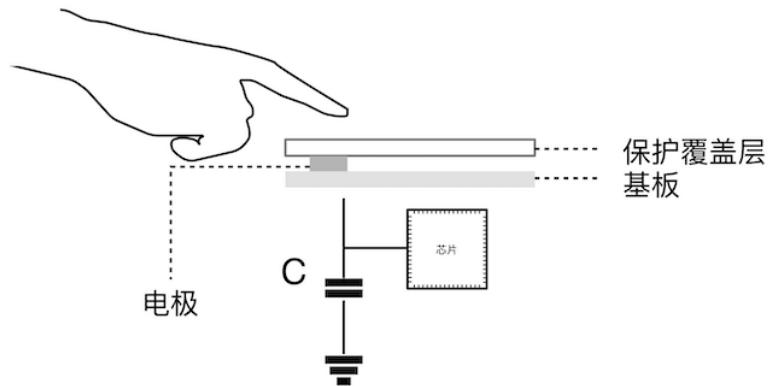


图 13: ESP32-P4 典型的触摸传感器应用

### 电极图形

适当大小和形状的电极有助于提高系统灵敏度。常见的有圆形、椭圆形和形状类似人的指尖的电极。过大或形状不规则的电极可能导致附近电极发生错误响应。

图[ESP32-P4 电极图形要求](#) 所示为适当以及不适当大小和形状的电极。注意图中未按照实际比例绘制，建议用指尖作为参考。

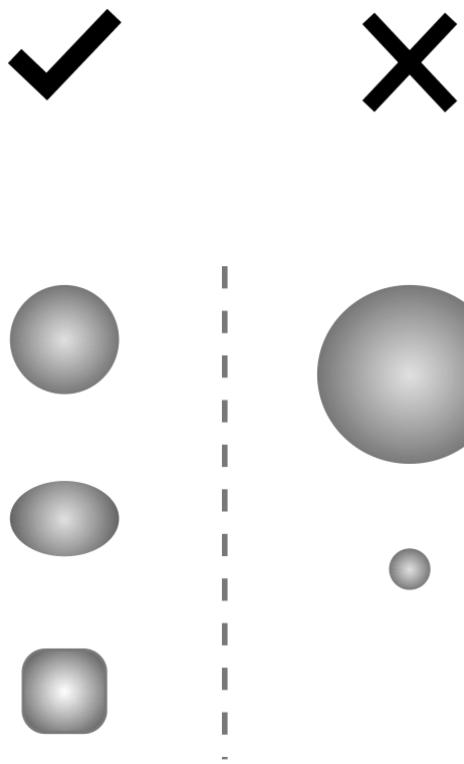


图 14: ESP32-P4 电极图形要求

### PCB 布局

图[ESP32-P4 传感器布局布线](#) 为传感器布线布局，具体的走线注意事项如下：

- 走线长度请尽量短，建议不超过 300 mm。
- 走线宽度 (W) 不能大于 0.18 mm (7 mil)。
- 走线夹角 (R) 不应小于 90°。
- 走线离地间隙 (S) 范围 0.5 mm 到 1 mm。
- 触摸电极直径 (D) 范围 8 mm 到 15 mm。
- 触摸电极和走线应被栅格地围绕。
- 触摸传感器电路注意远离射频天线电路，并注意隔离。

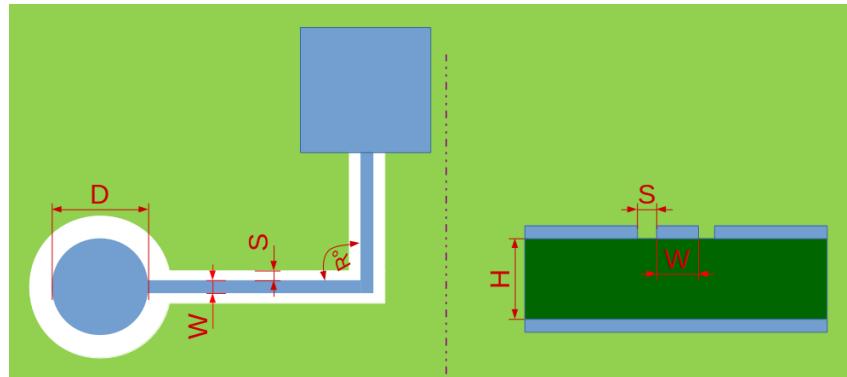
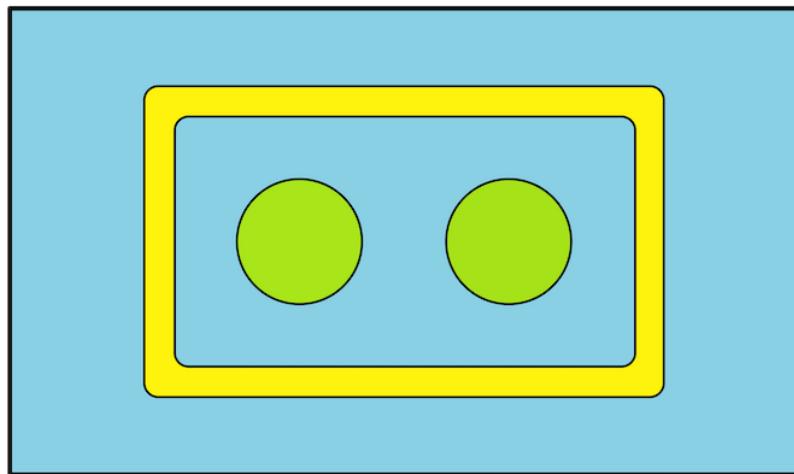


图 15: ESP32-P4 传感器布局布线

### 防水和接近传感器布局

ESP32-P4 新增硬件防水和接近传感器功能，图[ESP32-P4 防水和接近传感器参考布局](#) 为防水和接近传感器参考的布局。



- 触摸传感器 (TOUCH1 ~ TOUCH14)
- 保护传感器 (TOUCH1 ~ TOUCH14)
- 屏蔽电极 (TOUCH14)

图 16: ESP32-P4 防水和接近传感器参考布局

为更好实现上述功能，请注意以下事项：

- 屏蔽电极的宽度建议 2 cm。

- 顶层填充网格，走线宽度为 7 mil，网格宽度为 45 mil (25% 填充)，填充的网格与驱动屏蔽信号连接。
- 底层填充网格，走线宽度为 7 mil，网格宽度为 70 mil (17% 填充)，填充的网格与驱动屏蔽信号连接。
- 建议保护传感器应为弯曲边缘的矩形，包围其他所有传感器。
- 保护传感器宽度建议为 2 mm。
- 保护传感器与屏蔽传感器宽度间隙建议为 1 mm。
- 接近传感器的感应距离与接近传感器的面积成正比，但增大感应面积也会带来更大噪声，需实际测试。
- 接近传感器形状建议为闭合环状。宽度建议为 1.5 mm。

**备注：**更多关于触摸传感器的硬件设计可查看 [触摸传感器应用方案简介](#)。

#### 1.4.6 MIPI

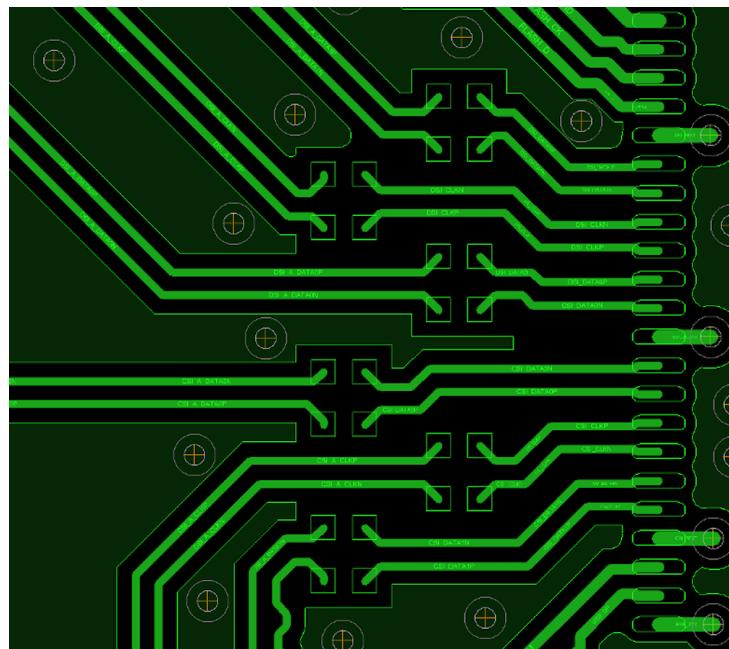


图 17: ESP32-P4 系列芯片 MIPI 版图设计

MIPI 版图设计应遵循以下规范：

- MIPI 走线因为速率较高，需要尽量控制其寄生电容。
- MIPI 的差分线阻抗控制标准是  $100\ \Omega$ ，误差不能大于  $\pm 10\%$ 。
- MIPI 线始终保持等长和等距；MIPI 线对之间的长度误差要控制在 10 mil 以内，线对与线对之间的长度误差控制在 30 mil 以内，需要时绕蛇形线。
- MIPI 线对之间建议包地隔离，如果没有办法包地，MIPI 线对之间要保持至少  $2W$  以上的间距，其中  $W$  为 MIPI 线宽。MIPI CLK 走线请包地处理。
- MIPI 信号线应远离其它高速、高频信号（并行数据线、时钟线等），至少保持  $3W$  以上的距离且绝不能平行走线，对开关电源这一类的干扰源更应远离。
- MIPI 信号线下方一定要有参考层（推荐用地层），且一定要保证参考层的连续性。
- 对于层数较多的 PCB 设计，建议 MIPI 走线在芯片引出后立即通过过孔引入内层，以降低高速信号线的干扰。同时，请在打孔换层的地方加一对地孔回流。

## 1.5 开发硬件介绍

### 1.5.1 ESP32-P4 系列开发板

请至乐鑫官网的 [开发板页面](#) 查看 ESP32-P4 系列开发板的最新详细信息。

### 1.5.2 下载指导

ESP32-P4 系列芯片支持通过 UART 和 USB 下载固件。

UART 下载的过程如下：

1. 烧录前，需要根据表[芯片启动模式控制](#) 设置芯片在 Joint Download Boot 模式。
2. 给芯片上电，通过 UART0 串口查看是否进入 Joint Download Boot 模式。如果串口显示“waiting for download”，则表示已进入 Joint Download Boot 模式。
3. 通过[Flash 下载工具](#)，选择 UART 方式将程序固件烧录进 flash 中。
4. 烧录结束后，GPIO35 可以悬空或者上拉切换至高电平，进入 SPI Boot 启动模式下工作。
5. 重新上电，芯片初始化时会从 flash 中读取程序运行。

USB 下载的过程如下：

1. 如果 flash 中没有能正常运行的程序固件，烧录前，需要根据表[芯片启动模式控制](#) 设置芯片在 Joint Download Boot 模式。
2. 给芯片上电，通过 USB 接口查看是否进入 Joint Download Boot 模式。如果显示“waiting for download”，则表示已进入 Joint Download Boot 模式。
3. 通过[Flash 下载工具](#)，选择 USB 方式将程序固件烧录进 flash 中。
4. 烧录结束后，GPIO35 可以悬空或者上拉切换至高电平，进入 SPI Boot 启动模式下工作。
5. 重新上电，芯片初始化时会从 flash 中读取程序运行。
6. 如果 flash 中有能正常运行的程序固件，可以直接从步骤 3 开始 USB 自动下载。

---

备注：

- 建议看到“waiting for download”的信息后再进行下载。
  - 串口打印工具和烧录工具不能同时占用一个串口端口。
  - 应用程序中如果出现以下情况，USB 自动下载功能将被禁用，必须通过配置 strapping 管脚进入 Joint Download Boot 启动模式，才能使用 USB 下载功能。
    - USB PHY 被应用程序关闭。
    - USB 被二次开发用于其他 USB 功能，例如 USB 主机、USB 标准设备。
    - USB 对应的 IO 管脚被用于其他外设功能，例如 UART、LEDC 等。
  - 建议用户保留对 strapping 管脚的控制，避免在出现以上情况时，USB 下载功能无法使用。
- 

## 1.6 相关文档和资源

### 1.6.1 ESP32-P4 系列模组

请至乐鑫官网的 [模组页面](#) 查看 ESP32-P4 系列模组的最新详细信息。

ESP32-P4 系列模组的参考设计请参考：

- [下载链接](#)

---

**备注：**请使用以下工具打开模组参考设计里的文件：

- .DSN 文件：OrCAD Capture V16.6
  - .pcb 文件：Pads Layout VX.2。如果无法打开.pcb 文件，请尝试用其他软件导入.asc 文件查看 PCB 版图。
- 

## 1.6.2 ESP32-P4 系列开发板

请至乐鑫官网的 [开发板页面](#) 查看 ESP32-P4 系列开发板的最新详细信息。

## 1.6.3 其他文档和资源

- [ESP32-P4 系列芯片](#)
- [乐鑫 KiCad 仓库](#)
- [乐鑫产品选型工具](#)
- [产品证书](#)
- [论坛 \(硬件问题讨论\)](#)
- [技术支持](#)
- [常见问题 \(ESP-FAQ\)](#)

## 1.7 词汇列表

词汇列表包含了本文档中使用的术语和缩写词。

词汇	描述
CLC	电容-电感-电容
DDR SDRAM	双倍速率同步动态随机存储器
ESD	静电释放
LC	电感-电容
PA	功率放大器
RC	电阻-电容
RTC	实时控制器
SiP	系统封装
0 Ω 电阻	常用作电路设计中的占位符，后续可根据具体设计替换为其他大小的电阻。

## 1.8 修订历史

表 9: 修订历史

日期	版本	发布说明
2025-11-28	v1.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>原理图设计</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 章节 <b>内部电压稳压器和外部 DCDC</b>: 更新 FB_DCDC 和 EN_DCDC 相关的说明</li> </ul> </li> </ul>
2025-09-22	v1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>原理图设计</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 章节 <b>内部电压稳压器和外部 DCDC</b>: 新增关于 VDDO_FLASH 默认电压及 1.8 V flash 使用注意事项的说明</li> </ul> </li> </ul>
2025-07-07	v1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>原理图设计</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 章节 <b>HP/LP IO 电源</b>: 新增 VDD_IO_5 相关的说明</li> <li>- 章节 <b>MIPI PHY 电源</b>: 更新 VDD_MIPI_DPHY 相关的描述, 增加 MIPI 信号电平相关的说明</li> <li>- 章节 <b>内部电压稳压器和外部 DCDC</b>: 更新 FB_DCDC 和 EN_DCDC 相关的描述</li> <li>- 章节 <b>SDIO</b>: 新增图 <b>ESP32-P4 SD 3.0 卡电源电路图</b></li> </ul> </li> <li>• <b>PCB 版图布局</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 章节 <b>电源走线通用要点</b>: 删除 VDD_FLASHIO 电源走线相关的描述, 更新 DCDC 放置相关的描述</li> </ul> </li> </ul>
2025-04-23	v1.0	首次发布《ESP32-P4 硬件设计指南》。

## 1.9 免责声明和版权公告

本文档中的信息, 包括供参考的 URL 地址, 如有变更, 恕不另行通知。

本文档可能引用了第三方的信息, 所有引用的信息均为“按现状”提供, 乐鑫不对信息的准确性、真实性做任何保证。

乐鑫不对本文档的内容做任何保证, 包括内容的适销性、是否适用于特定用途, 也不提供任何其他乐鑫提案、规格书或样品在他处提到的任何保证。

乐鑫不对本文档是否侵犯第三方权利做任何保证, 也不对使用本文档内信息导致的任何侵犯知识产权的行为负责。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权许可, 不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。蓝牙标志是 Bluetooth SIG 的注册商标。

文档中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产, 特此声明。